(51) 4 B 23 K 20/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

- (21) 3749785/25-27
- (22) 01.06.84
- (46) 15.08.86. Бюл. № 30
- (71) Белорусский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт
- (72) А.В.Степаненко, А.В.Гулай, В.Г.Войтов и Л.А.Колешко
- (53) 621.771.8(088.8)
- (56) Король В.К., Гильденгорн М.С. Эсновы технологии производства многослойных металлов. М.: Металлургия, 1970, с. 213-219.

(54)(57) МИКРОПРОВОЛОКА, содержащая выполненные из пластичного материала керн и охватывающую его оболочку, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что, с целью повышения качества микропроволоки при рабочей температуре, в качестве пластичного материала применяют сплав алюминия с никелем при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Алюминий Никель 93,0-99,9 0,1-7,0

35

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может найти при-менение при получении микропроволоки для сварки элементов полупроводниковых приборов и интегральных микросхем. 5

Целью изобретения является повышение качества микропроволоки путем увеличения ее пластичности при рабочей температуре.

Получают предлагаемую проволоку 10 путем нанесения на керн оболочки, например, методом термического распынения сплава в вакууме или магнетронным распылением. В качестве сплава, обладающего повышенной пластичностью при 15 рабочих температурах, т.е. обладающего эффектом сверхпластичности в интервале температур не выше 700°С, применяют сплав алюминия с никелем при следующем соотношении компонентов, 20 мас. %:

Алюминий 93,0-99,9 Никель 0,1-7,0

Ограничение в выборе материала, обладающего сверхпластичностью при 25 температуре ниже 700° С, обусловлено тем, что более высокие температуры недопустимы при микросварке давлением элементов полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, так как 30 они проводят к необратимым явлениям в полупроводниковом кристалле.

Выбор концентрации примеси никеля (0,1-7,0 мас.%) в материале оболоч-ки или керна обусловлен следующими причинами.

При концентрации меньше 0,1 мас. 7 положительный эффект не достигается, т.е. повышение пластичности микропроволоки не происходит. В случае концентации более 7 мас. 7 атомы примесей приводят к значительному разупрочнению кристаллической решетки алюминия, что увеличивает удельное сопротивление проволоки.

Предлагаемая микропроволока при определенной температуре, достигае-мой в зоне контакта при микросварке, переходит в состояние сверхпластичности. При этом снижаются контактные напряжения в зоне микросварки, облегчается и ускоряется процесс пластической деформации, что приводит, соответственно, к ускорению процесса схватывания соединяемых материалов. При этом резко увеличивается скорость диффузионных процессов, требуется намного меньше времени для

релаксации механических напряжений, возникающих в процессе деформации. Указанные явления приводят в конечном итоге к повышению качества микросварных соединений.

Например, сплав алюминия с никелем (6,4 мас.% Ni) обладает сверхпластичностью при 550°С. Данная температура развивается в зоне соединения в процессе термокомпрессионной микросварки, микросварки сопротивлением и достигает данных значений в локальных участках контакта при ультразвуковой микросварке, следовательно, материал оболочки и/или керна микропроволоки будет переходить в состояние сверхиластичности в процессе сборки изделий микроэлектроники. Указанный сплав обладает 20 достаточно высокими критериями сверхпластичности: относительным удлинением δ и коэффициентом чувствительности к скорости деформации т. Величина в при растяжении без разруше-**25** ния возрастает с 38 (при 20°C) до 210% (в условиях сверхпластичности). а коэффициент m=0,37 (проявление сверхпластических свойств возможно при m>0.3).

Ускорение релаксации механических напряжений, возникающих при микросварке, является конкурирующим процессом для роста нитевидных кристаллов. Поэтому использование предлагаемой микропроволоки позволяет значительно уменьшить число нитевидных кристаллов, снизить вероятность закорачивания входных контактов с подложкой и повысить надежность изделий микроэлектроники.

Кроме того, предлагаемая микропроволока обладает повышенной коррозионной стойкостью при повышенной температуре и влажности. Это обусловлено наличием в сплаве соединения NiA ℓ_3 , электродный потенциал которого выше, чем у алюминия, и равен 0,73 В по сравнению с 0,85 В для чистого A ℓ .

Плотность силава Al+Ni растет линейно до значения 2,710 г/см³, соответствующего 0,58% Ni, т.е. пористость материала уменьшается, что привоцит к снижению взаимодействия его с парами воды и уменьшению толщины поверхностных окисных пленок. При уменьшении толщины окисного слоя облегчается его разрушение на начальной стадии процесса микросварки, при этом в зоне соединения меньше оскол-ков разрушенного окисного слоя и, следовательно, больше фактическая площадь микросварного контакта и вытше его межаническая прочность.

Микропроволока из сплава Af+Ni может быть выполнена в следующих вариантах: керн проволоки из алюминия, меди или другого металла, а оболочка из сплава Af+Ni; керн проволоки из сплава Af+Ni, а оболочка из другого металла или сплава, например алюминия; керн и оболочка из сплава Ai+Ni.

Пример. При диаметре алюминиевой микропроволоки 35 мкм оболочку получали путем сплавления алюминия и никеля на испарителе и последующего осаждения сплава на поверхности микропроволоки. Толщина оболочки составляла ~1,2 мкм. Осуществляли присоединение разработанной микропроволоки к алюминиевой пленке на полу- 25 проводниковой пластине методом ультразвуковой микросварки при $t_{cs} = 0,03 c$, Р =0,4 Н. На электромеханический преобразователь подавали напряжение колебаний широкого спектра частот U.=40 В. Получали гистограммы распределения усилий на разрыв микросварных соединений. Если при использовании алюминиевой проволоки без оболочки с добавками Ni максимум кривой распределения прочности микросварных соединений приходится на 0,08-0,10 Н и при введении добавки Ni в материал оболочки в количестве 0,05 мас.% прочность практически не изменяется, то при 0,1 мас. % Ni максимум кривой распределения прочности приходится на 0,12-0,14 H, а при ~0,6% Ni на 0,16-0,20 H.

Измеряли также контактное сопротивление R_k микросварных соединений четырехзондовым методом. Значение R_k при введении добавок 0,1-7 мас. $% N_1 = 10^{-3}$ Ом. При увеличении содержания никеля более $% N_2 = 10^{-3}$ Ом. $% N_3 = 10^{-3}$ Ом. $% N_4 = 10^{-3}$ Ом.

Полупроводниковые приборы с ис-15 пользованием разработанной микропроволоки диаметром 35 мкм с оболочкой. выполненной из алюминия с добавками никеля, подвергали термической обработке при 125° С в течение 1000 ч. После проведения обработки полсчитали длину и количество нитевидных кристаллов. При введении 6,4 мас. % Ni общая длина нитевидных кристаллов уменьшается на 40-45% по сравнению со случаем использования микропроволоки без введения Ni. Приборы испытывали также в камере тепла и влаги при 65°C и 95%-ной относительной влажности. При испытаниях 50% отказов приборов с использованием алюминиевой проволоки без оболочки происходит в течение 210 ч. Полный выход из строя приборов наблюдается соответственно в течение 180 и 960 ч. Отказы приборов происходят вследствие коррозионных разрушений микросварных соединений.

Таким образом, коррозионная стойкость изделий при использовании предлагаемой проволоки повышается в 5,3-5,5 раза.

Составитель И.Николаева
Техред О.Гортвай Корректор В.Бутяга

Заказ 4364/13

Редактор Л. Веселовская

Тираж 1001

Подписное

ВНИИПЕ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г.Ужгород, ул.Проектная, 4